

Einzel IC-Buchsenkontakte auf Kunststoffträger RM 2,54mm Single IC Female Contacts on Plastic Holder 2.54mm Pitch

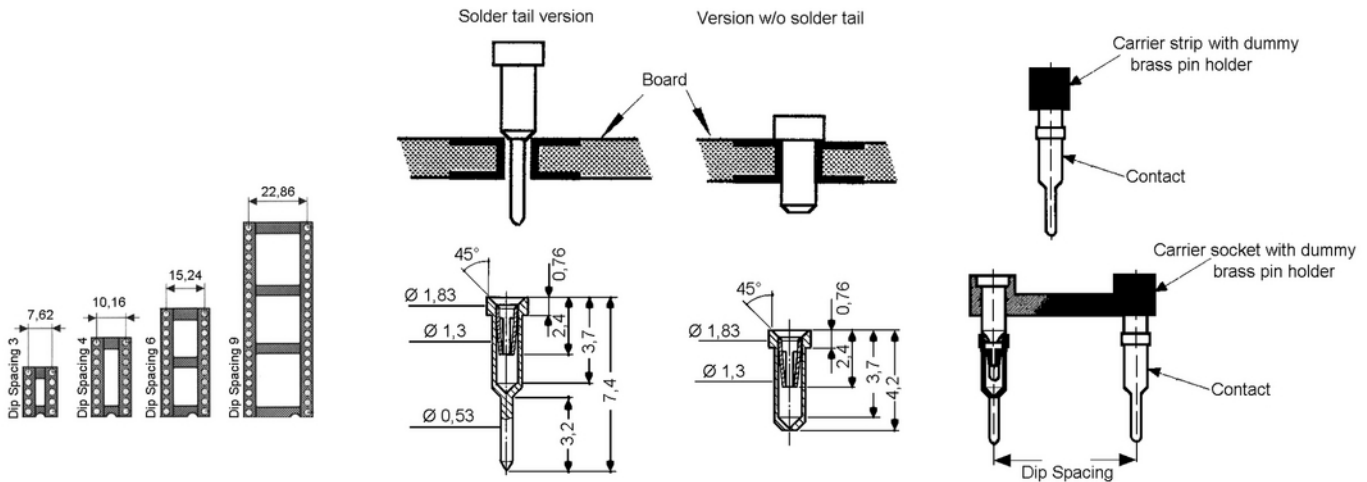
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Contact Material	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	IEC 60512-12A
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{RMS}
Test Voltage	1kV _{RMS}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Voltage Rating	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø 0,4 ... 0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25 x 0,45mm.
For round pins Ø 0.4 ... 0.56mm
or square pins 0.25 x 0.45mm.



Series	Contacts*	DIP*	Terminal*	Sleeve Plating	Clip Plating*
325	14	9	10	50	00
325 Träger IC-Fassungen <i>Carrier IC-Sockets</i>	06/08/10/ 12/14/16 ==> 18/20/22/ 24/28/32 ==> 10/24/28/ 32/36/40/ 42/48/50/52==> 50/52/64 ==>	3 7,62mm	10 Mit Einlötlanschluß <i>With solder tail</i> 20 Ohne Einlötlanschluß <i>W/o solder tail</i>	50 Verzinkt (Standard) <i>Tin plated (Standard)</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 Vergoldet 0,25µm <i>0.25µm gold plated</i> 30 Vergoldet 0,75µm <i>0.75µm gold plated</i>

Series	Contacts*	Rows	Terminal*	Sleeve Plating	Clip Plating*
325	18	1	10	50	00
325 Träger IC-Leisten <i>Carrier IC-Headers</i>	01-64 Einreihig <i>Single row</i>	1 Einreihig <i>Single row</i>	10 Mit Einlötlanschluß <i>With solder tail</i> 20 Ohne Einlötlanschluß <i>W/o solder tail</i> 30 wie 20, Ø 0,94 / L = 3,6 mm <i>like 20, Ø 0.94 / L = 3.6 mm</i> 40 wie 20, Ø 0,94 / L = 6,3 mm <i>like 20, Ø 0.94 / L = 6.3 mm</i>	50 Verzinkt (Standard) <i>Tin plated (Standard)</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 Vergoldet 0,25µm <i>0.25µm gold plated</i> 30 Vergoldet 0,75µm <i>0.75µm gold plated</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* **This is an order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperature T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

